

电子元件失效分析方法，电泳盐雾测试

产品名称	电子元件失效分析方法，电泳盐雾测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电子元件失效分析方法，电泳盐雾测试

样品进行断面检测，底部存在锡少，虚焊的现象。且芯片底部焊锡与PCB焊锡未完全融合。

焊锡高度检测

引脚焊锡高度0.014mm

芯片底部焊锡高度0.106mm

说明

芯片引脚位置焊锡高度0.014mm，芯片未浮起，芯片底部高度为0.106mm，锡膏高度要大于芯片底部高度才能保证焊接完好。

SEM检测

说明

对底部焊接的位置进行SEM检测，芯片与PCB之间焊锡有缝隙，焊锡未完全融合，IMC致密性差，高度5 μm 左右。